

牛津仪器CMI165系列用于测试高/低温的PCB铜箔、蚀刻或整平后的铜厚度定量测试、电镀铜后的面铜厚度测量，在PCB钻孔、剪裁、电镀等工序前进行相关铜箔来料检验。

仪器规格：

厚度测量范围：化学铜：0.25 μ m–12.7 μ m（0.01mils–0.5mils）

电镀铜：2.0 μ m–254 μ m（0.1mil–10mil）

线性铜线宽范围：203 μ m–7620 μ m（8mil–300mil）

仪器再现性：0.08 μ m at 20 μ m（0.003 mils at 0.79 mils）

显示单位：mil、 μ m、oz

操作界面：英文、简体中文

存储量：9690条检测结果（测试日期时间可自行设定）

测量模式：固定测量、连续测量、自动测量模式

统计分析：数据记录，平均数，标准差，上下限提醒功能

CMI165配置包括：

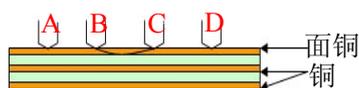
- CMI165主机
- SRP-T1探头
- NIST认证的校验用标准片1个



仪器特点：

- 应用先进的微电阻测试技术，符合EN14571测试标准。SRP-T1探头由四支探针组成，AB为正极CD为负极；测量时，电流由正极到负极会有微小的电阻，通过电阻值和厚度值的函数关系准确可靠得出表面铜厚，不受绝缘板层和线路板背面铜层影响
- 耗损的SRP-T1探头可自行更换，为牛津仪器专利产品
- 仪器的照明功能和SRP-T1探头的保护罩方便测量时准确定位
- 仪器具有温度补偿功能，测量结果不受温度影响
- 仪器为工厂预校准
- 测试数据通过USB2.0 实现高速传输，可保存为Excel文件
- 仪器使用普通AA电池供电

微电阻原理



SRP-T1 探头



联系人：刘志军 手机：15814404453 邮箱：419723738@qq.com QQ：419723738



深圳市鼎极天电子有限公司——牛津仪器中国区一级代理商

地址：深圳市宝安区创业路25区福尔园建商务中心5楼503室

Tel: 0755-27832900

Fax: 0755-27857558

Web: www.digitophk.com

